

QJ

中国航天工业总公司航天工业行业标准

QJ 3113 - 99

多层印制电路板用粘结片 复验规则和方法

1999 - 04 - 02发布

1999 - 11 - 30实施

中国航天工业总公司 发布

多层印制电路板用粘结片复验规则和方法

1 范围

1.1 主题内容

本标准规定了多层印制电路板用粘结片（简称粘结片）的复验规则和复验方法。

1.2 适用范围

本标准适用于航天产品用多层印制电路板制造中使用的粘结片的复验。

2 引用文件

GB 10243-88 多层印制板用粘结片预浸材料

3 定义

本章无条文。

4 一般要求

4.1 粘结片在到货后应根据订货标准，对品种、规格、数量、包装情况、生产日期以及相关质量证明文件等项目进行核对验收。并且对其主要性能在按本标准逐项复验合格后，才能投入使用。

4.2 在对粘结片生产厂家进行了评审（例如：质量体系、质量标准、生产条件等）的情况下，可以增加或减少复验项目。

4.3 试验环境条件：温度 15~35℃，相对湿度 45%~75%，气压 86~106kPa。

5 详细要求

5.1 复验项目及要求

5.1.1 外观质量

按 5.4.1 条的方法检验，粘结片玻璃布应平整，无油污，无破裂和过多的树脂粉末形迹，无外来杂质或其它缺陷，但允许有龟裂纹。表面污点和尘埃不允许大于 0.25mm。在任一 30cm×30cm 面积内：污点和尘埃不多于 2 处；折痕长度大于 50mm 的不多于 2 条；